



2024年5月8日

各 位

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 会 社 名 | イリソ電子工業株式会社 |
| 代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 鈴木 仁 (コード番号:6908) 取 締 役 |
| 問い合わせ先 | 副社長執行役員 豊嶋 光由 管 理 本 部 長 |
| 電 話 番 号 | 045-478-3111 (代表) |

2026 中期経営計画に関するお知らせ

当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、2026 中期経営計画について決議しましたので、お知らせいたします。

記

当社は、中期経営計画期間の2024～2026年度（2025年3月期～2027年3月期）を、課題克服と成長軌道への回帰に向けた足場固めの3年間と位置付け、2027年3月期に売上高650億円、営業利益率15%超の達成を目指す計画を策定しました。

事業規模拡大において市場別では、販売台数が増加する電動車向けの拡販を加速するとともに、ECU(Electric Control Unit)統合化の流れを掴み製品の市場投入を進めて参ります。また、課題であるセンサー分野（カメラ分野）やインダストリアル市場を飛躍的成長実現に向けた土台づくりの期間と位置づけ、注力分野として2027年以降の飛躍的拡大を推進して参ります。

モノづくり力強化においては、生産性・工場稼働率の向上に努め、設備の共有化、金型内製化の拡大や資材費の低減、設計VEなどを通じコスト削減を進め利益率向上を図って参ります。

<重点施策>

- 「車載のイリソ」から「モビリティのイリソ」への基盤構築
 - ・パワートレイン分野：ワールドワイドでの事業拡大、高電流・耐振動・耐熱性能の更なる向上
 - ・統合 ECU 分野：高速 BtoB コネクタに加え、統合 ECU 化に向け WtoB（ワイヤー to ボード）スケーラブルコネクタ投入によるラインアップ拡充
 - ・センサー分野：共同開発等によるカメラ事業再構築、新規顧客開拓
 - ・車載で培った耐振・耐熱、高速伝送を武器に、建機、農機、eVTOL 等のモビリティ市場への事業ポートフォリオ拡大
- インダストリアル市場のグローバル強化～ 第二の柱に成長するための土台づくり
 - ・高速フローティング BtoB コネクタによる新規顧客開拓とシェア拡大、商社等活用による販売チャンネル拡大、調達品による品揃え強化
 - ・グローバル FAE(Field Application Engineer)による新規顧客開拓、現地対応力強化
 - ・半導体製造装置、エネルギーマネジメント領域の事業構築

3. ワールドワイドでの生産体制見直し、設備・金型の標準化拡大による生産性・投下資本効率の向上
 - ・全生産拠点の体制・役割を見直し、生産効率 15%改善、秋田工場の円滑な立ち上げ、国内生産比率の向上
 - ・DXを活用した製品・設備・金型設計の生産性向上、標準化、内製金型拡大によるコスト削減、リードタイム短縮
 - ・現地調達、集約購買拡大による資材費低減、樹脂・めっき等の使用量削減
4. 資本コストと株価を意識した経営の強化
 - ・資本コストを上回る ROIC 達成を図り、最適な資本構成による投資効率の改善を実現
 - ・成長投資と株主還元のバランスを取り、配当性向 40%超または株主資本配当率（DOE）5%を目標に株主還元
5. サステナブル経営の更なる深耕
 - ・人と環境にやさしい経営～再生可能エネルギー積極利用、リサイクル・再利用の促進
 - ・多様な人財作り～役員・管理職人財の多様化、働き方、処遇改善を通じたエンゲージメント向上
 - ・経営基盤の強化～グローバルリスクマネジメントの強化、デジタル経営基盤の構築、セキュリティ向上

<業績目標>

| | 23 年度実績 | 26 年度目標 |
|-----------------|---|--|
| 売上高 | 553 億円 | 650 億円 |
| 営業利益 | 59 億円 | 100 億円 |
| 営業利益率 | 10.7% | 15.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56 億円 | 75 億円 |
| EPS | 238 円 | 330 円 |
| ROE | 7.8% | 10% |
| ROIC | 7.3% | 10% |
| 売上高研究開発費率 | 2.4% | 3.5% |
| 為替前提※ | USD : 144.40 円 ユーロ : 156.80 円 人民元 : 20.14 円 | USD : 140 円 ユーロ : 155 円 人民元 : 20 円 |

※中期経営計画期間の為替レート設定は140円/ドル、155円/ユーロ、20円/人民元
(ただし2025年3月期は145円/ドル、160円/ユーロ、20円/人民元)

なお、詳細につきましては、添付資料「2026 中期経営計画」をご覧ください。

以 上



2026中期経営計画

証券コード：6908

2024年5月8日

IRISO 電子工業株式会社
IRISO ELECTRONICS CO.,LTD.

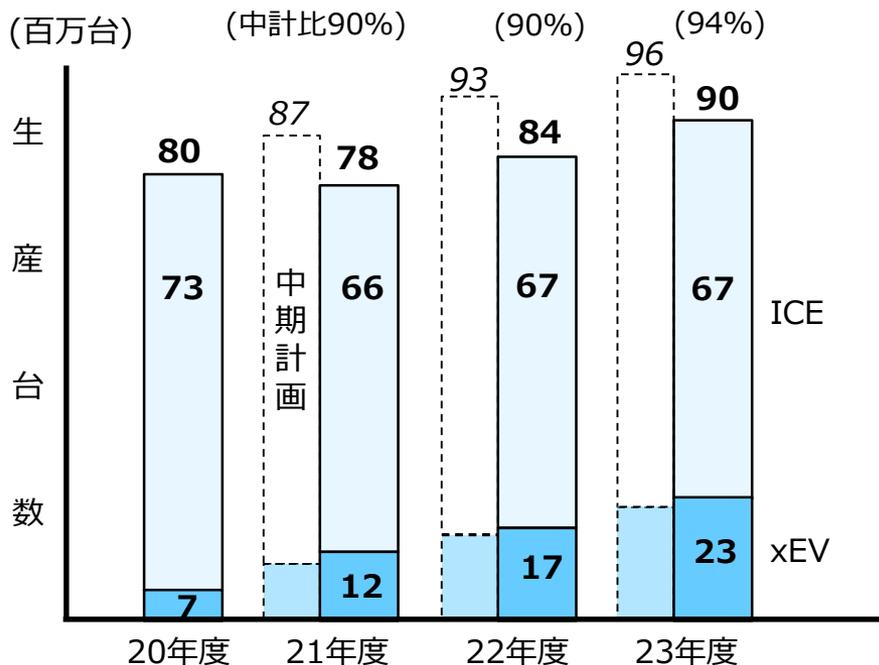
私たちは、社会やお客様の期待を超える「つなげる」を実現します
Together, surpassing expectations by empowering connections
to enrich society and delight people.

1.1 2023年中期経営計画と実績

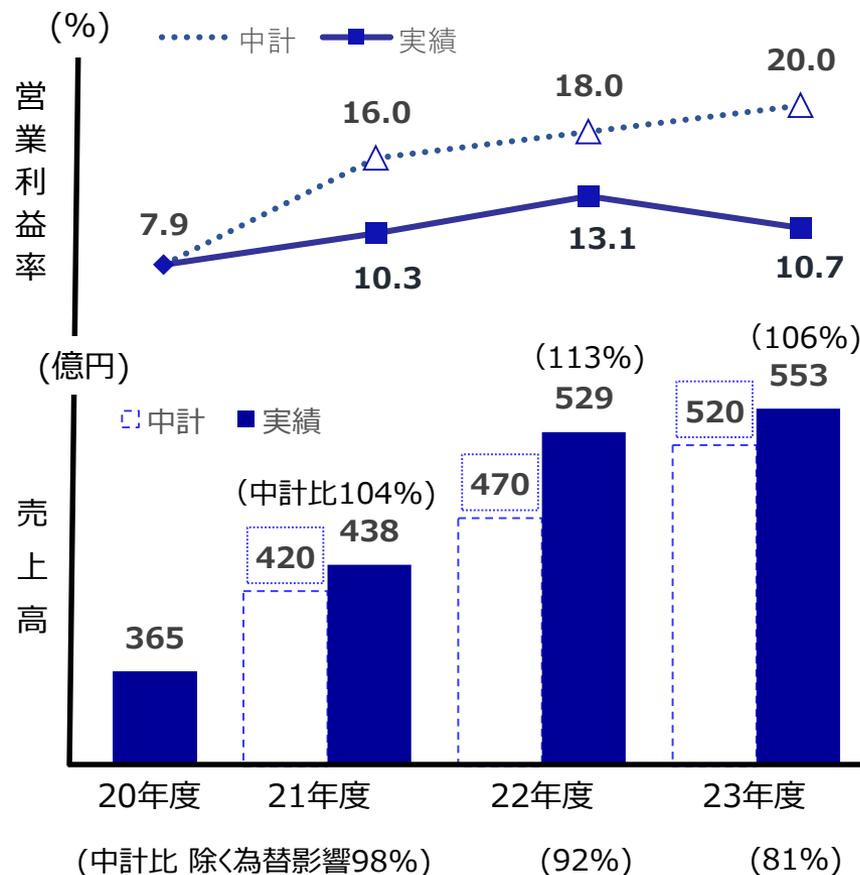
自動車市場の急回復・xEVシフト加速を取り込み、成長軌道への回帰、長期ビジョン売上1,000億円達成の足場固めを実現

⇒ 自動車市場の回復遅れ、中国経済の減速等を十分に跳ね返すことができず、為替影響を除く売上高は目標未達、収益性の改善も回復途上

[世界自動車生産台数]



(富士キメラ総研・銀行・証券等各社のレポートを参考に当社作成)
 中期計画策定時の数値は販売台数、実績/見通しは生産台数



1.2 2023年中期経営計画の成果、課題

| 重点施策 | 成 果 | 重 点 課 題 |
|-------------------------|---|---|
| 車載市場の強化 | <ul style="list-style-type: none">✓中国xEV市場パワートレイン向けコネクタの市場地位を獲得✓高耐振動“Z-MoveTM”コネクタ拡販✓将来のコア事業である統合ECU向け高速伝送BtoBコネクタラインアップ確立 | <ul style="list-style-type: none">✓カメラ事業の強化✓W/W（ワールドワイド）でのパワートレイン製品販売強化・拡大 |
| 第二の柱の早期確立 (インダストリアル) | <ul style="list-style-type: none">✓5G通信基地局向け25Gbps伝送対応FFCコネクタ投入✓制御系機器向け多極・フローティング・高速伝送対応製品の戦力化 | <ul style="list-style-type: none">✓攻める市場の明確化✓グローバル展開 |
| 生産力、コスト力、品質力強化 | <ul style="list-style-type: none">✓規格品の複数拠点生産体制確立✓収益構造改善プロジェクト推進によるコスト削減の実施✓花巻工場建設、金型内製化拡大 | <ul style="list-style-type: none">✓投資効率・設備稼働率の向上✓政治的リスク回避、リードタイム短縮に向け、地産地消継続推進 |
| 経営インフラの強化 | <ul style="list-style-type: none">✓ESG対応に向けたデータ整理、改善施策の立案、社内外への発信情報充実✓新ERPシステム2024年4月稼働完 | <ul style="list-style-type: none">✓CO2排出削減施策の実践、人財多様化、エンゲージメント向上 |

※ECU : Electronic Control Unit 電子回路制御装置

2.1 中期経営計画目標

- 「車載のイリソ」から「モビリティのイリソ」への基盤構築
- インダストリアル市場のグローバル強化
- W/Wでの生産体制見直し、設備・金型の標準化拡大による生産性・投下資本効率の向上
- サステナブル経営の更なる深耕

クルマの電動化・
自動運転、全産
業の高速伝送で
社会に貢献

売上の成長

CAGR5%以上

営業利益率

23年度10.7%→26年度15%以上

ROE

23年度 7.8%→26年度10%以上

ROIC

23年度 7.3%→26年度10%以上

サステナブル社会
の実現に向けて

カーボン
ニュートラル

CO₂排出原単位(Scope1-3) 10%削減

人財

DE&I強化、エンゲージメント向上

経営基盤

品質、安全、コンプライアンス、リスクマネジメント

2.2 中期経営計画目標数値と市場予測

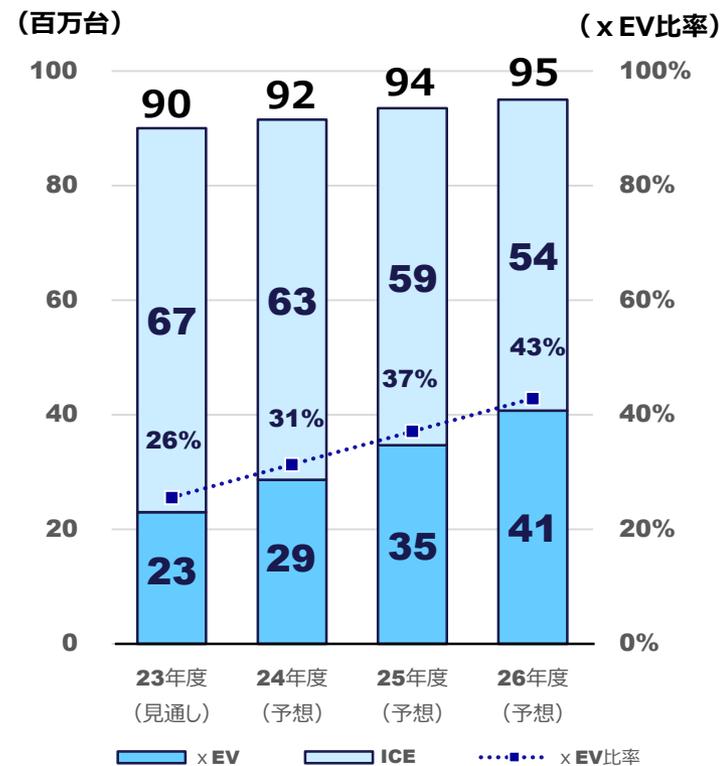
- 26年度売上高650億円、営業利益率15%超を目標
- 為替レートはUSD140円、EUR155円、RMB20円を設定
- 世界自動車生産台数は26年度95百万台と緩やかに増加、xEV構成比率は26年度に40%超まで成長

【26年度目標数値】

| | 23年度実績 |
|-----------------|--|
| 売上高 | 553億円 |
| 営業利益 | 59億円 |
| 営業利益率 | 10.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56億円 |
| EPS | 238円 |
| ROE | 7.8% |
| ROIC | 7.3% |
| 売上高研究開発比率 | 2.4% |
| 為替前提※ | USD 144.40円 ユーロ 156.80円 人民元 20.14円 |

| | 26年度目標 |
|-----------------|---------------------------------|
| 売上高 | 650億円 |
| 営業利益 | 100億円 |
| 営業利益率 | 15.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 75億円 |
| EPS | 330円 |
| ROE | 10% |
| ROIC | 10% |
| 売上高研究開発比率 | 3.5% |
| 為替前提※ | USD 140円 ユーロ 155円 人民元 20円 |

【世界自動車生産台数】



(富士キメラ総研・銀行・証券等各社のレポートを参考に当社作成)

※24年度のみUSD145円、ユーロ160円

- パワートレイン・統合ECU分野で業界No.1の地位構築
- センサー分野、インダストリアル市場の飛躍的成長実現に向けた土台づくり

モビリティ

パワートレイン

インフォテインメント
統合ECU

センサー

【推進内容】

- ✓ パワートレイン分野、センサー分野及びインフォテインメント分野で飛躍的に成長が見込まれる統合ECUを注力分野として推進
- ✓ センサー分野は成長に向けた土台づくり
- ✓ 車載で培った耐振・耐熱、高速伝送を武器に、建機、農機、eVTOL等のモビリティ市場への事業ポートフォリオ拡大 ※eVTOL : Electronic Vertical Take Off Landing aircraft 電動垂直離着機

インダストリアル

製造装置
通信 エネルギー

【推進内容】～第二の柱に成長するための土台づくり

- ✓ 制御機器向けのW/W展開
- ✓ ロボット・AI関連向けの品揃えを強化
- ✓ 半導体製造装置、通信（データセンター）、エネルギーマネジメント（充電器、蓄電器）分野への参入強化

2.4 車載における当社製品の強み

コアコンピタンス

- ・フローティング技術
～Z-Move構造
- ・2点接点構造
- ・Auto I-Lock構造

Auto I-Lock™ (11501シリーズ)

FPC/FFCカード挿入時、自動ロックされる構造を開発し、不完全嵌合をなくし、自動組立による顧客生産性向上に貢献

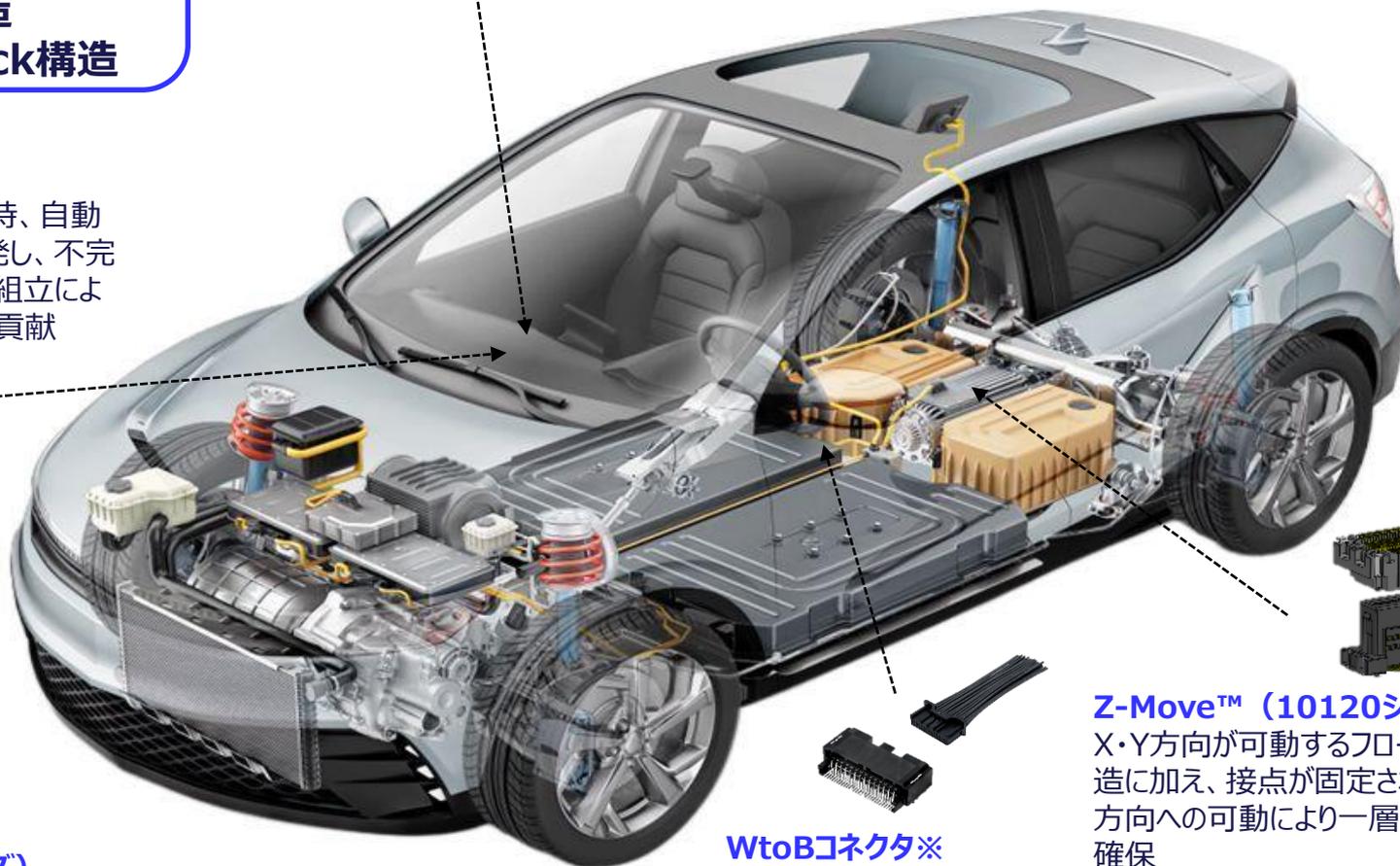


2点接点 (10109シリーズ)

接触不良防止
嵌合時に異物の除去
インストルメントパネル・パワートレインに搭載



高速伝送付フローティングBtoBコネクタ(10143シリーズ)
25Gbpsの高速伝送に加え、ピッチ幅を超える可動量を両立
電源用端子を配置し、コネクタ全体の小極化を実現



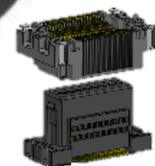
WtoBコネクタ※ (13065シリーズ)

小型・低背、高い耐熱性に
よりパワートレイン他に採用



Z-Move™ (10120シリーズ)

X・Y方向が可動するフローティング構造に加え、接点が固定されたままZ方向への可動により一層の耐振性を確保



※WtoB : Wire to Board
基板とワイヤーを結ぶインターフェイスコネクタ

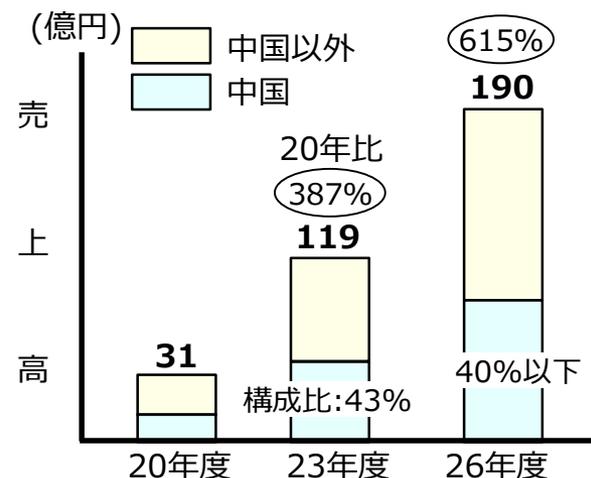
W/Wでの事業拡大、高電流・耐振動・耐熱性能の更なる向上

➤ 21~23年の成果

- ✓ 中国xEVで高いシェアを獲得
 - ・ハウジング～端子まで含む小型WtoBコネクタとしてソリューション提供
 - ・小極から大極までの豊富な品揃え
- ✓ 耐振性に優れた“Z-Move™”コネクタラインアップを拡充し、インバーター・コンバーター用コネクタの売上拡大
- ✓ 製品ラインナップを背景に、OBC（車載用充電器）やACインバーター用コネクタも伸長

➤ W/W展開に向けた製品開発と販売強化

- ✓ 中国・日本国内での実績をベースに、欧州・米州等の規格対応製品の拡販推進
- ✓ 高電流、耐振動、耐熱性能向上に向け、技術開発継続と開発期間の短縮



3.1 パワートレイン分野（2）

- 駆動系・バッテリー系に加え、外部給電用ACインバータ等その他アプリケーションへの受注拡大を推進
- EVのみならずPHEV・HEV等、幅広い採用実績

| アプリケーション | | EV | PHEV | HEV |
|----------|---|----|------|-----|
| 駆動関係 | コンバーター  | ○ | ○ | ○ |
| | インバーター  | ○ | ○ | ○ |
| バッテリー関係 | BMS(バッテリーマネジメントシステム)  | ○ | ○ | ○ |
| | OBC（車載用充電器）  | ○ | ○ | — |
| その他 | 外部供給用ACインバーター  | ○ | ○ | ○ |

高速BtoBコネクタに加え、統合ECU化に向けWtoBスケーラブルコネクタ投入によるラインアップ拡充

➤ 21～23年の成果

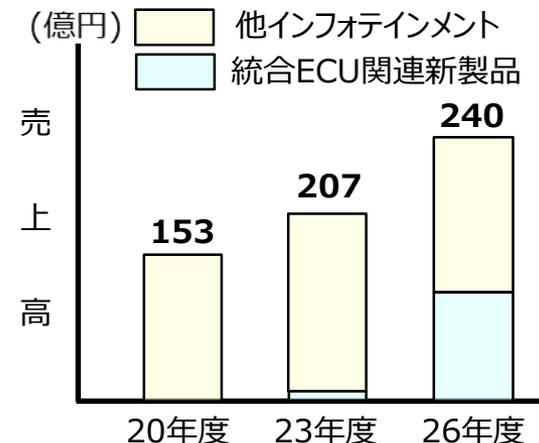
- ✓ 電動化、自動運転等の進化により、ECU搭載数・基板の内部接続が増加
⇒車載市場で信頼を築き上げた当社高速BtoBコネクタ提案により、過去にない多数の顧客からの受注獲得、量産体制の確立
- ✓ ECUの統合化を見据え、スケーラブルコネクタの製品コンセプト確立

自動車1台に100個超のECUが必要
⇒車両コスト増、設置スペース不足

複合化された統合ECUの需要拡大
⇒拡張機能を備えた「スケーラブルコネクタ」を提案

➤ 市場を読み・リードする製品開発と供給

- ✓ 高速BtoBコネクタを更なる高速化、大容量化、小型・軽量化へ向けた技術革新を進め、ラインアップ[®]拡充、販売シェア拡大を図る
- ✓ スケーラブルコネクタの市場投入



モビリティ視点でのセンサー分野成長に向けた土台づくり

➤ 21～23年の成果と課題

✓ 自動運転の進化による高速伝送・高画質・大容量の需要拡大

⇒ Radar、LiDAR市場向け製品の開発・販売を強化

※Radar : Radio detection and ranging 電波による探知
LiDAR : Light Detection And Ranging 光による検知

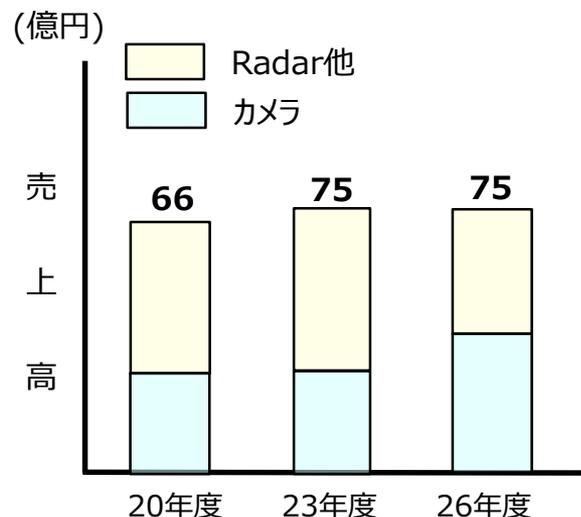
✓ カメラ市場ニーズ見誤り、技術的課題による製品開発遅延で売上伸びず



➤ 共同開発等によるカメラ事業再構築

✓ ビュー、センシング、ドライバーモニタリングシステム向け製品のラインアップ拡充と拡販(Level 2～3対応)、高機能製品(高周波、高速等)の開発強化(Level 3～5対応)

✓ 他社とのアライアンスによるクロスセルを通じ、新規顧客開拓とシェア拡大



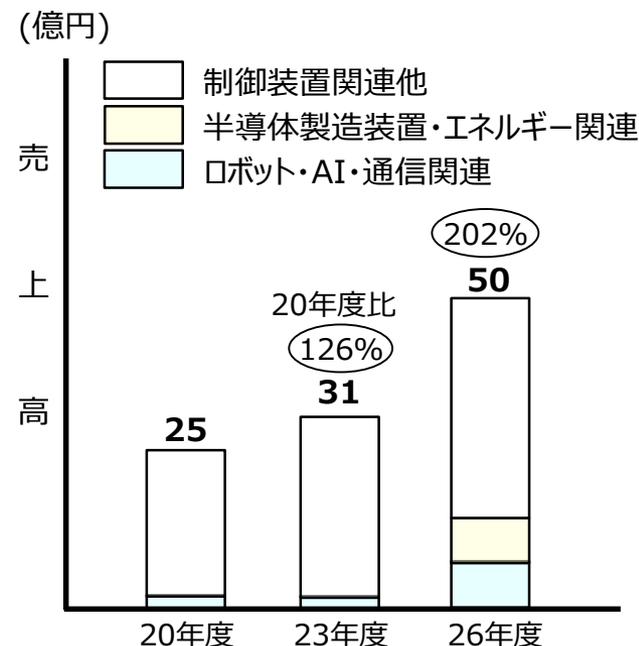
第二の柱に成長するためのインダストリアル市場の土台づくり

➤ 21～23年の成果と課題

- ✓ 日系企業の制御機器向け拡販、5G通信基地局向け25Gbps伝送対応FFCコネクタ投入等により、23年は生産調整にて苦戦するも、21・22年では売上高43億円/年と20年比173%まで伸長
 - ✓ 市況悪化による23年の売上鈍化、グローバル展開の遅れ等課題はあるが、EUにてグローバルFAEを採用するなど対策を実施
- ※FAE : Field Application Engineer

➤ グローバル展開と製品拡充

- ✓ 高速フローティングBtoBコネクタを中心に日系大手企業に対する新規顧客開拓とシェア拡大
- ✓ グローバルFAEによるEU新規顧客開拓、現地対応力強化
- ✓ 商社等活用による販売チャネル拡大、調達品による品揃え強化を通じ販売手法の見直し
- ✓ 半導体製造装置、エネルギーマネジメント領域の事業構築



拠点体制整備による生産性・投資効率向上、原価低減の推進

➤ 21～23年の成果と課題

- ✓ 規格品複数拠点生産体制確立、収益構造改善プロジェクト推進による原価低減、花巻工場新設による金型内製化拡大を実施
- ✓ 先行投資増により、生産拠点の設備稼働率・投資効率の向上は道半ば

➤ 生産性・稼働率向上

- ✓ 全生産拠点の体制・役割を見直し、生産効率15%改善
- ✓ 秋田工場の円滑な立上げ、国内生産比率の向上

➤ 設備・金型の共有化、コスト削減

- ✓ DXを活用した製品・設備・金型設計の生産性向上、標準化
- ✓ 内製金型拡大によるコスト削減、リードタイム短縮

➤ 資材費低減、設計VE

※VE: Value Engineering
価値工学

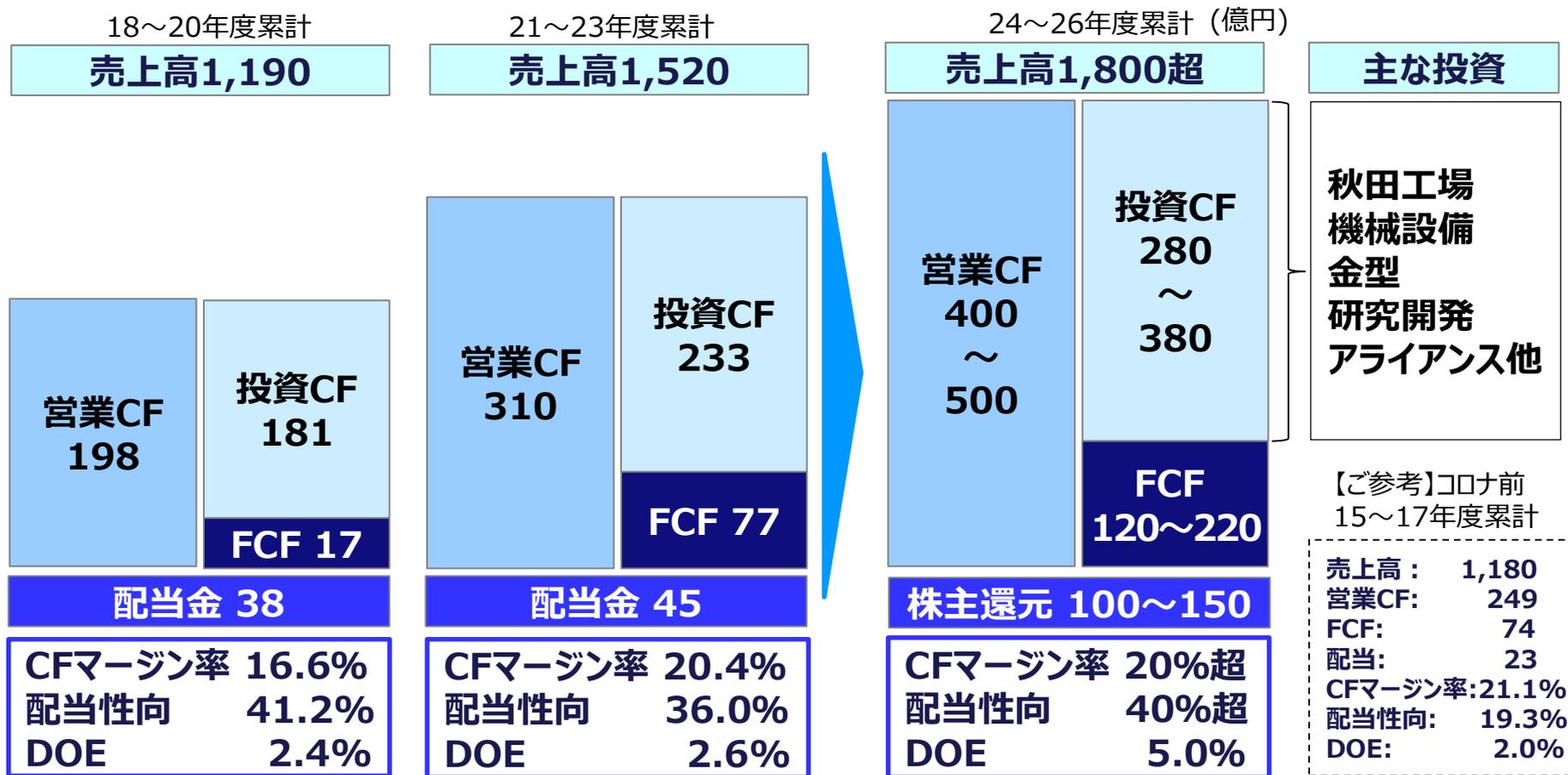
- ✓ 材料統一、樹脂・めっき等の使用量削減
- ✓ 現地調達化、集約購買の推進

【主要KPI】

| 項目 | 23年度 | 26年度 |
|-------|------|------|
| 売上原価率 | 69% | 65% |

4.1 キャッシュ創出とキャピタルアロケーション

- 営業キャッシュフローマージン率20%超の継続実現
- 成長投資と株主還元のバランスを取り、配当性向40%超または株主資本配当率（DOE）5%を目標に株主還元



4.2 資本コストと株価を意識した経営

- 現状のPBRが1倍前後で推移していることを重く受け止め、中期経営計画で掲げた成長戦略と収益構造改革をやり遂げ、経営基盤の再構築を図り、ROE10%以上を継続できる経営を推進
- 資本コストを上回るROIC達成を図り、最適な資本構成を実現し、更なる投資効率の改善を実現
- 配当性向40%超またはDOE5%を目標に安定した株主還元を実施するとともに、自己株式取得も行き、株主還元の拡充を図る

| | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 26年度目標 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ROE | 6.4% | 4.1% | 6.8% | 8.6% | 7.8% | 10.0% |
| ROIC | 6.3% | 4.0% | 6.6% | 8.3% | 7.3% | 10.0% |
| 配当金/1株 (円) | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 150 |
| 配当性向 | 35.8% | 55.0% | 36.1% | 34.0% | 37.9% | 40%超 |
| DOE | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.8% | 2.8% | 5.0% |
| PBR (倍) | 1.47 | 2.14 | 1.28 | 1.71 | 0.94 | 1.50 |

経営理念

**-未来に続く架け橋として-
人の心を尊重し豊かな価値を創り社会貢献に努める**

Statement

社会やお客様の期待を超える「つなげる」を実現

Purpose

お客様の声と提案力で、電路をつなぐ、安心、安全、快適な接続を創造

Dream

「つなげる」を深化させ、人と環境にやさしく、様々な機能を容易につなげる未来を創造

Belief

お客様への感謝、そして感動を。

ありたい姿

- **社会やお客様の期待を超える「つなげる」で、成長を続ける企業**
- **社会、環境、品質を重視し、社員とステークホルダーが「わくわく」する企業**

イリソが持続的成長を実現するための5つの重要課題

| マテリアリティ | 主要KPI | 23年度 | 30年度 |
|----------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| ① 社会課題の解決と事業成長の実現 | モビリティの自動化・電動化に貢献する売上高比率 新製品売上高比率 | 35% 23% | 40% 30% |
| ② 価値創造を支えるモノづくり力の変革 | 売上高原価率7%改善 | 69% | 62% |
| ③ 人と環境にやさしい安心、安全、快適な社会への貢献 | 電力由来CO2排出実質ゼロ（25年） 温室効果ガス排出20%減（30年、21年比） 工場の電力原単位30%向上（30年、21年比） | 45kt 283kt 1.05kt | 実質0 167kt 0.95kt |
| ④ 多様な人財づくり | 管理職に占めるダイバーシティ（外国人、女性、中途採用者）比率 従業員エンゲージメントスコア | 84% 48pt | 90% 53pt |
| ⑤ 経営基盤の強化 | ROE ROIC | 7.8% 7.3% | 10%超 10%超 |

➤ 人と環境にやさしい経営

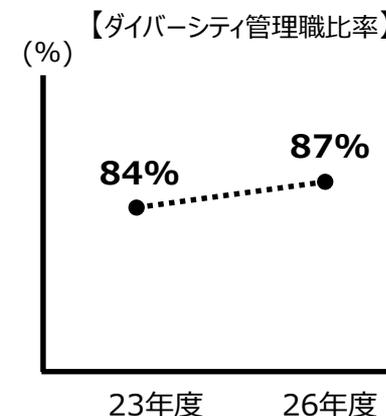
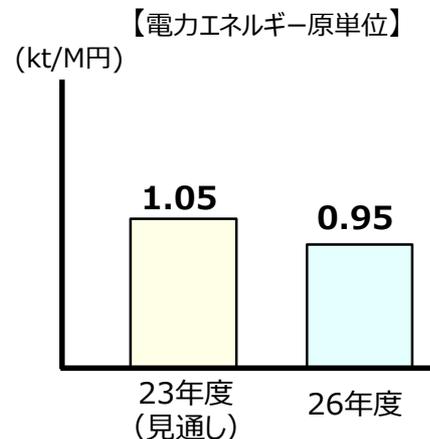
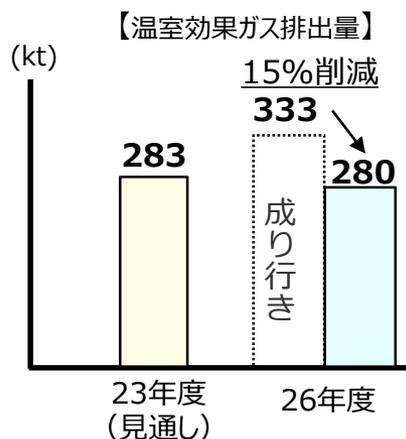
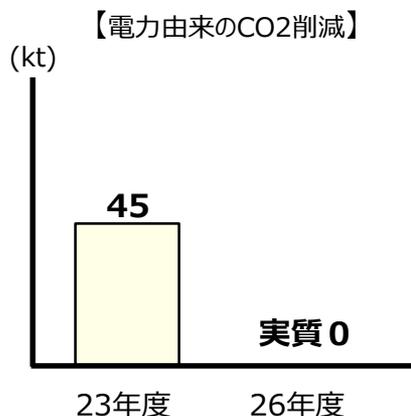
- ✓ 再生可能エネルギー積極利用、リサイクル・再利用の促進
- ✓ サプライチェーンを通じた脱炭素・資源循環型社会への貢献

➤ 多様な人財作り

- ✓ 役員・管理職人財の多様化
- ✓ 働き方、処遇改善を通じたエンゲージメント向上

➤ 経営基盤の強化

- ✓ グローバルリスクマネジメントの強化
- ✓ デジタル経営基盤の構築、自動化推進、セキュリティ向上
- ✓ 資本コストと株価を意識した経営



| | |
|------|--|
| 会社名 | イリソ電子工業株式会社 |
| 事業内容 | 各種コネクタの製造・販売 |
| 設立年月 | 1966年12月 |
| 社員数 | 単体586名、連結3,037名(2024年3月31日現在) |
| 資本金 | 5,640百万円(2024年3月31日現在) |
| 本社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-8 |
| 営業拠点 | |
| 国内 | 本社、福島県、茨城県、愛知県、大阪府 |
| 海外 | シンガポール、香港、アメリカ、ドイツ、タイ、韓国 中国(上海、大連、天津、蘇州、深圳、重慶)、台湾、インド |
| 研究開発 | 本社(イリソテクノロジーパーク)、 川崎(生産技術センター)、岩手県、上海R&Dセンター |
| 工場 | 茨城県、中国(上海、南通)、フィリピン(マニラ)、 ベトナム(ハイズオン) |

コネクタの種類

基板対基板コネクタ (BtoBコネクタ)

プリント基板の接続用に開発されたコネクタの総称でボード・ツー・ボードコネクタ(ボードtoボードコネクタ)とも呼ばれる。垂直接続、平行(スタッキング)接続、水平接続など組み合わせで、さまざまな接続が可能となる。B to B (ビー・ツー・ビー)は、当社の登録商標として市場で広く浸透している。

FPC/FFCコネクタ

FPC基板(Flexible printed circuits)やFFCケーブル(Flexible flat cable)の接続用に開発されたコネクタの総称。コネクタの挿入時に力を加えずにロック可能なZIF(Zero insertion Force)タイプ、挿入したときに力が発生するNON-ZIFタイプがある。

IFコネクタ

IFとは、インターフェイスの略で、機器間の信号の接続を行うコネクタのことで、I/O(インプット/アウトプット)コネクタとも呼ばれる。カーナビ、PCなどさまざまな機器の側面(裏・表面)に装着され、機器への電源供給、音声・映像信号データなどの入出力を行う。

ピンヘッダー

線材をカット加工した“ピン(電導体)”をハウジング(樹脂材でできた絶縁体)で支えたプラグ(オス側)コネクタの基本形であり、さまざまな分野・機器の内部接続(基板間接続)に使用されている。横から見ると、生け花の花止め“けんざん”のように見えるのが特長。メス側はソケットと呼ばれる。

この資料に記載されております業績の予想数値につきましては、本資料の発表日現在で得られた入手可能な資料に基づいて作成したものであり、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみにより判断されることはお控え下さるようお願いいたします。

なお、本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。